

## Datenblatt

einlagige und zweilagige Leiterplatten

Basismaterialien	Standard FR4	
	min. Materialstärke	0,5 mm
	max. Materialstärke	3,2 mm
	min. Kupfer-Dicke	18 µm
	max. Kupfer-Dicke	105 µm
	T <sub>g</sub>	130/150/170 °C
Layout	Strukturbreite	150 µm
	Strukturabstand	150 µm
	umlaufende Löstoplack-Freistellung	125 µm
	kleinster Löstoplack-Steg	150 µm
	kleinste Restringe	150 µm
	kleinste Bohrung	300 µm
	kleinster Fräsradius	500 µm
	kleinster Ritzwinkel	30 °
Oberfläche	HAL bleifrei	
	HAL SnPb	
	chem. Zinn	
	chem. Ni/Au	
	chem. Ag	
	Hartgold, Bondgold	
	Carbondruck	
Löstoplack	grün / schwarz / blau / rot ...	
	superweiß (für LED- Anwendungen)	
	abziehbare Lötdeckmaske	
	Kaptonband	
Kennzeichendruck	weiß / gelb / schwarz ...	
Qualitätskontrolle	optische Kontrolle	
	elektrischer Test	
	Erstmusterprüfung	
Daten	vorzugsweise Gerberdaten	
	Eagle	
	TARGET, PROTEL, Altium, etc.	
	Filme Musterplatinen	
Zertifikate / Normen	ISO 9001:2008	
	UL	
	IPC-A-600	
andere Materialien und Ausführungen auf Anfrage		